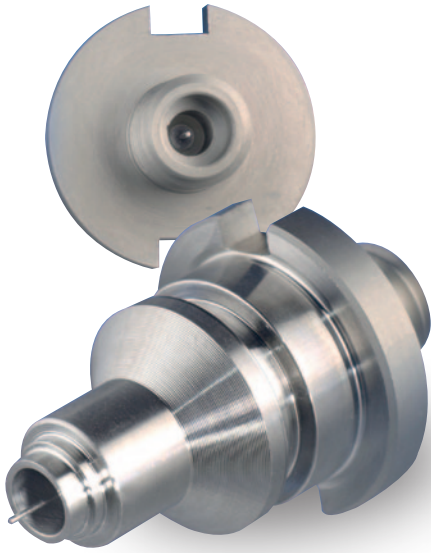


INHALT

Januar 2023



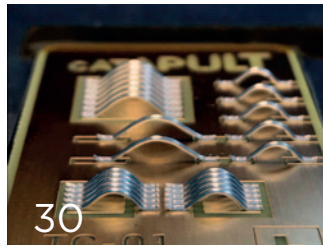
82

Ein laserbasiertes Verfahren zur Herstellung von Druckglasdurchführungen wird am Fraunhofer Institut für Lasertechnik untersucht



26

Wie könnten sich die weltweiten Chipmärkte entwickeln? Erwartet wird ein Abschwung



30

Ein Gemeinschaftsprojekt optimiert die Erstellung von 3D-Modellen für Powermodule



51

Dr. Hayao Nakahara gibt Einblicke in die Leiterplattenproduktion Asiens

EDITORIAL

Jede Krise bringt gewaltige Chancen für den Fortschritt mit sich

1

DESIGN

Effiziente Designlösung für Powermodule

30

AKTUELLES

NEWS & Trends

5

Chips als Motor des Datenzeitalters

13

electronica 2022 – Ausgewählte Beispiele

17

Pressekonferenzen und Paneldiskussionen

20

TERMINE & Events

23

LEITERPLATTENTECHNIK

Auf den Punkt gebracht (H. J. Friedrichkeit): Chinas Appetit auf Taiwan

38

Adrenalin, Wagemut und Entscheidungsklarheit

46

Die Leiterplattenindustrie 2023

49

Nakaharas ‚Blick nach Asien‘:

Die Leiterplattenproduktion in Fernost

51

BAUELEMENTE

Weltweite Chipmärkte: Wird 2023 das Jahr des Abschwungs?

26

BAUGRUPPEN & SYSTEME

embedded world Exhibition & Conference 2023

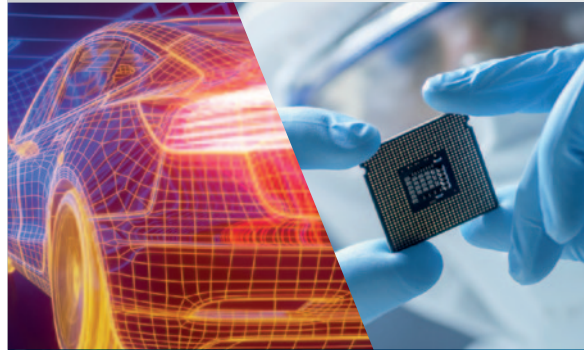
62



ventec
INTERNATIONAL GROUP
騰輝電子

Qualitativ hochwertige Basismaterialien und Prepregs

Flexible, zuverlässige Supply-Chain-Lösungen



Ventec International Group

Ventec ist Spezialist für die Herstellung von hochwertigen Basismaterialien und Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz liefert kundenspezifische Supply-Chain-Lösungen in allen Regionen der Welt. Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren in China, Großbritannien, Deutschland und USA, ist niemand besser positioniert, um die Bedürfnisse der globalen Leiterplattenindustrie zu bedienen.



www.ventecclaminates.com



62

Am 14.-16. März trifft sich in Nürnberg das ,Who is Who' der embedded Community - und vielversprechende Vorträge sind angekündigt



63

SMT-Technologierennen: Ein Bericht über das 23. Europäische Elektroniktechnologie-Kolleg (EE Kolleg) auf Mallorca

BAUGRUPPEN & SYSTEME

Wer erringt die Pole-Position im SMT-Technologierennen? 63

ANALYTIK & TEST

Aufbruch zu neuen Horizonten beim Technologieforum 74

FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Laser statt Ofenprozess 82



Beim Reflowlöten von Leiterplatten kommen Öfen zum Einsatz – doch es wird mit der belastenden Hitze nicht immer vorsichtig umgegangen

FORUM

Kostelniks „PlattenTeknik“: Was bringt uns das Jahr 2023	89
Kolumne: Kastanien aus dem Feuer holen	91
PLUS-Firmenverzeichnis	96
Im Heft redaktionell erwähnte Firmen	123
Stellenanzeigen	124
Inserentenindex	125
Mediadaten	126
Impressum	127
Gespräch des Monats: Interview mit Robert Piterek und Sven Gramatke	128

Titelbild

Die D. Kaupke Leiterplatten Service GmbH präsentiert sich als Komplettanbieter rund um die Entwicklung, Beschaffung von Leiterplatten, deren Bestückung und Komplettmontage.



Diese Dienstleistung wird in den Bereichen: Luftfahrt, Automotive, Medizintechnik, Industrieelektronik, Messtechnik, Datentechnik und Telekommunikation angeboten.

Weitere Informationen:
Telefon: +49 (0)911 968796-0, www.kaupke.de

Die Fachzeitschrift PLUS enthält exklusive Mitglieder-Informationen folgender Fachverbände:



Fachverband Elektronik-Design e. V.
Tel. +49 30 340 60 30 50
info@fed.de, www.fed.de

34



EIPC – Der Europäische
Elektronik-Verband
Tel. +31 46 4264258
www.eipc.org

43



Fachverband Electronic
Components and Systems
Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

57



Fachverband PCB
and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org



INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS
AND PACKAGING SOCIETY –
Deutschland e. V.
Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

67



Forschungsvereinigung
Räumliche Elektronische
Baugruppen 3-D MID e. V.
Tel. +49 911 5302-9100
info@3dmid.de, www.3dmid.de

78



DVS – Deutscher Verband
für Schweißen und
verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0
romina.krieg@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

88